

Title (en)

Process for the electrochemical roughening of aluminium surfaces in the manufacture of offset printing plates.

Title (de)

Verfahren zum elektrochemischen Aufrauen von Aluminiumoberflächen bei der Herstellung von Offsetdruckplatten.

Title (fr)

Procédé de grainage électrochimique des surfaces en aluminium dans la fabrication des plaques d'impression offset.

Publication

**EP 0143932 A1 19850612 (DE)**

Application

**EP 84111438 A 19840926**

Priority

DE 3339410 A 19831029

Abstract (en)

[origin: US4564429A] In a method of electrochemically roughening aluminium surfaces in the manufacture of offset printing plates, use is made of an electrolyte containing nitric acid, boric acid and water. Alternating current is employed and the material to be roughened is passed as a continuous band through the electrolyte. The electrolyte contains from three to fifteen g/l of aluminium. The current density employed is between 15 and 90 A/dm<sup>2</sup>.

Abstract (de)

Bei einem Verfahren zum elektrochemischen Aufrauen von Aluminiumoberflächen bei der Herstellung von Offsetdruckplatten wird ein Salpetersäure, Borsäure und Wasser enthaltender Elektrolyt verwendet. Es wird mit Wechselstrom gearbeitet, und das aufzurauhende Material wird als kontinuierliches Band durch den Elektrolyten hindurchgeführt. Im Elektrolyten wird eine Aluminiummenge von 3 bis 15 g/l eingehalten. Die angewandte Stromdichte liegt zwischen 15 und 90 A dm<sup>2</sup>.

IPC 1-7

**C25F 3/04**; B41N 1/08

IPC 8 full level

**B41N 1/08** (2006.01); **B41N 3/03** (2006.01); **C25F 3/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B41N 3/034** (2013.01 - EP US); **C25F 3/04** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [XP] US 4416972 A 19831122 - WALLS JOHN E [US], et al
- [AD] US 4336113 A 19820622 - WALLS JOHN E, et al
- [XD] EP 0089508 A1 19830928 - HOECHST CO AMERICAN [US]

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0143932 A1 19850612**; **EP 0143932 B1 19871111**; AT E30747 T1 19871115; DE 3339410 C1 19910829; US 4564429 A 19860114

DOCDB simple family (application)

**EP 84111438 A 19840926**; AT 84111438 T 19840926; DE 3339410 A 19831029; US 65880884 A 19841009